

四川华丰科技股份有限公司

关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案的半年度 评估报告

为积极践行“以投资者为本”的理念，贯彻落实上海证券交易所“关于开展科创板公司‘提质增效重回报’专项行动的倡议”，四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于对未来发展的坚定信心、对企业价值的深刻认识以及对社会责任的认真履行，制定了《2026 年“提质增效重回报”行动方案》，该方案于 2026 年 4 月 13 日经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。2026 年上半年公司根据行动方案内容积极开展和落实相关工作，具体情况如下：

一、推动经营质效新突破

公司坚持“科技领先、AI 智造、全球化布局、数字化转型”战略路径，2026 年上半年公司实现营业收入 12.61 亿元，同比增长 14.09%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.47 亿元，同比下降 2.23%。

（一）推动业务突破，构建增长支柱

1.通信市场多元拓展，从单点突破到生态化合作。上半年公司紧抓 AI 算力爆发机遇，112G 高速线模组及背板连接器实现批量交付，224G 产品持续升级迭代。客户结构从华为向阿里、字节等互联网及服务器厂商加速拓展。与浪潮、超聚变、曙光等头部设备商深度合作，构建多层次、可持续的客户合作体系，降低单一市场依赖。

2.深耕新能源汽车赛道。上半年公司高压连接器成功进入多家主流车企供应链，产品结构逐步调整优化，高速、高压产品已在多个新能源汽车厂商开展装车验证，上半年高压连接器收入同比增长，核心能力建设与产品结构升级同步推进。

3.布局低空经济，以标准引领构建产业话语权。上半年公司依托防务航空高可靠、轻量化技术优势，完成低空经济领域技术储备与客户对接。深度参与无人系统、城市空中交通（UAM）等低空经济领域的连接器标准制定与产业联盟建设，部分项目已获取订单，为未来增长奠定基础。

（二）管理变革，提升组织动力

1.深化流程变革，构建支撑战略高效落地的组织运营体系。上半年公司完成

14 个业务域 L1-L3 流程架构发布，统一流程建设标准与语言；采购域流程变革完成三分之二核心流程设计；营销&销售业务流程架构（L1-L4）搭建完成；虹翼系统上线应用，推进数据贯通工程，落地智能化应用，提升跨部门协同效率。

2.智能制造从“单点改善”到“系统升级”的跨越式发展。公司以精益管理为基础，系统性构建了“精益化、自动化、智能化”三化融合的制造体系：建成华丰精益 2.0 级管理能力，培育精益骨干 112 名、精益种子 20 名，各产业单元已具备自主开展精益改善的能力；累计落地自动化项目超 140 项，覆盖激光加工、AOI、影像测量、AGV 等核心领域。

3.人力资源管理体系实现了从“事务管理”到“战略赋能”的系统性升级。在人才引进层面，改善效果显著，上半年公司核心关键岗位及时到位率提升至 80%；校招质量大幅提升；完成苏州研发团队搭建；完善全周期人才培养体系，启动内部讲师队伍建设，推动组织绩效从“结果评价”向“过程管理”延伸，打造高度自主、充满活力的价值创造团队。

二、推动技术创新迭代

（一）加大研发投入及创新要素配置

报告期内，公司围绕“高速”“系统”发展战略，制定中长期技术战略规划，持续加大研发投入，增长率达 40%以上，重点向高速互连核心技术攻关及系统级解决方案开发倾斜，确保创新资源与战略方向精准匹配。

研发体系建设方面，公司全面引进 IPD 集成产品开发方法，系统构建研发管理体系。一是导入技术规划与技术研究流程，实现技术异步研发，确保前沿技术储备先于产品需求完成布局；二是建立产品开发体系，以连接器研发、系统类产品研发、项目管理为核心，打通从需求分析、概念设计、详细开发到量产导入的产品研发主流程，缩短开发周期、提升交付质量；三是围绕知识标准化与产品标准化两条主线，推进企业各类设计规范、技术标准及模块化平台建设，建立技术重用机制，降低重复开发成本，提升研发效率。

信息化支撑方面，报告期内启动了新一轮 PLM 产品生命周期管理系统的需求调研与方案论证工作，旨在打通研发数据链路、强化项目过程管控，为研发效率的持续提升提供数字化底座。

（二）推进新技术和新产品研发

公司聚焦连接器及系统互连解决方案，围绕“高速”和“系统”核心战略，深耕防务、通讯、工业及低空产业板块，推动技术创新与产品迭代。

1.通讯领域，聚焦信号完整性、超高精度制造及新型板端端接集成技术攻关，取得多项核心突破。超高速信号互连方面，突破 224Gbps 速率下极致阻抗波动控制、信道插入损耗压降及极低串扰抑制等核心难题，推出 NPC 连接器及模组、高速背板连接器及模组等多款 224G 铜缆高速连接产品，已在 AI 算力集群实现工程化应用，全通道传输性能达行业领先水平。突破 PCIe6.0 产品应用技术，应用于算力传输与数据存储，成功开发了 PCIe6.0 背板产品与 MCIO、DACEM、GenZ、EDSFF 1035 等通用标准插槽类产品。主要包括标准连接器及线模组产品。该系列产品的成功开发为后续 PCIe7.0 & PCIe8.0 产品的研发与应用奠定了扎实的基础。通过塑胶局部电镀的技术攻关，突破高速信号完整性技术，成功开发了 MHT PCIe6.0 & MHT 112G 高速背板连接器和高速模组产品，应用于 AI 服务器。通过金属粉末注射成型技术（MIM）的技术攻关，突破高速信号完整性技术，成功开发了 112G 2MM 高速背板产品，应用于基站设备。通过高速信号完整性仿真与精密 SMT 结构设计技术攻关，成功突破了 112Gbps PAM4 高速 I/O 连接器设计与制造技术，开发出 OSFP 112G 板载 I/O 连接器产品。通过对材料结构和性能技术攻关，突破电源连接器通流能力升级技术，成功开发了 500A 以上的鸭嘴连接器产品，应用于 AI 服务器母排取电场景。突破系统化抗辐照设计及蝶形全气密封装工艺（平行缝焊/激光封焊），开发 4 发 4 收 10G 气密抗辐照光模块，实现空间辐射环境下稳定光电转换与在轨长期工作能力，满足空间卫星光通讯需求。

2.防务领域，通过毛纽扣接触件技术攻关，突破星载板间高速互连技术，应用于商业卫星。通过对箭载 EWIS 技术攻关，突破了超低温、超高温的防护技术，成功开发耐高温、低温的特种电缆组件，实现了商业航天领域供货的突破。通过高密度多信号集成传输技术攻关，突破传统无缆化机柜点位密度低、信号传输单一的技术瓶颈，应用刚柔板搭配浮动连接器全新架构，实现单背板超 8000 点、整机超 32000 点的超高密度无缆化传输应用。开发了宇航用 GWY 系列多个规格的连接器的产品，产品应用于高温、高真空环境，实现信号及大电流的可靠传输。

3.工业领域，突破 16A~600A 全电流快充连接技术，开发模块化直流快充

电插座及小尺寸交直流一体充电插座，性能超国标。突破 45A 以下电流等级核心难点，平台化开发新一代小尺寸 282 系、582 系连接器。突破基于电力电子器件替代传统保险丝与继电器的智能配电技术，开发第二代智能配电产品。

4.低空领域，聚焦 eVTOL 及大型无人机配套，围绕高可靠、轻量化、集成化、低成本持续攻关。连接器方面，开发 J599H/J599GY 高压连接器，适配 1000V 平台；开发 J599S5 轻量化连接器，较常规减重最高 46%；开发 J599S5D、J30JD 低成本连接器，满足低空成本敏感机型对连接器的选型需求。EWIS 方面，重点聚焦敏捷化、可靠性设计研究，从输入数据确定到设计发布周期压缩至 30 天以内，提速 30%以上；突破线束视觉缺陷识别技术，实现全过程数据追溯。PDU 方面，突破高压直流配电安全管控、轻量化结构设计及多回路精准保护技术，开发机载智能配电盒，已搭载飞行器并开展适航工作。

（三）提升科技成果转化和产业化水平

公司强化技术管理与资源协同，构建起国家战略导向与企业自主创新深度融合的创新生态体系。依托 3 个省级以上创新平台，联合电子科技大学等机构，打造产学研用一体化的高水平协同创新模式，围绕高速连接器信号传输完整性、精密制造、自动化检测等关键技术实现重大突破，攻克了降低损耗、抑制串扰等行业共性难题，形成系统性专利集群，有效打破国外技术壁垒。

报告期内荣获省级科技进步三等奖，公司申报的四川省高速连接器创新工程获得省级科技进步三等奖，目前已完成公示，标志着企业科技创新能力迈上新台阶。**智能制造获省级认定**，公司大力推进“智改数转”，引入智能检测装备等先进设备，关键工序自动化率显著提升，全面达到《智能制造能力成熟度模型》二级及以上标准，实现生产经营数据互通共享、关键生产过程精准控制和全链条协同管控。建设的“高速连接器 5G+AI 智能工厂”被认定为 2026 年四川省“先进级智能工厂”，目前已完成公示，标志着公司智能制造水平迈上新台阶；**产学研合作纵深推进**，公司与电子科技大学共建“系统互连与高速传输联合实验室”；联合新华三、烽火、重庆赛宝、四川华鲲振宇等单位，汇聚国产 AI 算力产业链上下游核心力量，共同申报多项 2026 年工信部高质量发展专项项目，进一步深化了协同创新与成果转化能力。

在技术/产品研发过程中，引入专利导航，以“创造—保护—运用—管理”全

链条成果保护为主线，成果创新与成果保护并行，提升成果市场转化潜力。报告期内公司新申请专利 76 项，其中新申请发明专利 27 项，实用新型专利 37 项；新增授权专利 24 项，其中发明专利 9 项，实用新型专利 13 项。截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计获得授权专利 753 项和软件著作权 5 项，其中发明专利 194 项，实用新型专利 525 项，外观设计专利 34 项。专利实施转化率达到 70%，实现了专利申请量与转化率的双提升。

三、提升治理效能与关键少数建设

（一）规范运作方面。2026 年上半年，公司深化治理体系建设，在治理制度方面，制定并审议了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》，进一步夯实了治理基础。在信息披露方面，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，履行信息披露义务，累计披露公告及相关文件 69 份，其中包括定期报告 2 份、ESG 报告 1 份，确保信息披露内容的真实、准确、完整，提升公告的可读性与逻辑性。在 ESG 治理实践中，公司主动发布《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》及摘要，万得 ESG 评级由 A 级提升至 AA 级，并成功入选华证 2026 四川省级 A 股 ESG 优质企业名单，公司在绿色运营、社会责任、合规治理成果获得权威平台认可。

（二）投资者沟通方面。2026 年上半年，公司持续完善多元化投资者沟通机制，通过业绩说明会、现场调研、线上会议、网络互动平台及投资者热线等多种渠道，加强与投资者的双向交流，有效增进市场对公司的了解与认同。期间，公司积极参加上海证券交易所组织的“对话成长：AI 重塑‘算-存-联’格局：年报视角看国产 AI 硬科技突围”集体业绩说明会，以线上视频形式深入交流公司在高速连接器领域的技术前瞻布局，生动展现核心竞争优势，同时进一步提升了披露内容的可读性与实用价值。

（三）“关键少数”沟通方面。2026 年上半年，公司持续强化控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的责任意识与合规意识，组织现任董事、高级管理人员参加上海证券交易所及上市公司协会举办的规范运作等专题培训，督促“关键少数”全面掌握证券市场法律法规，切实增强底线思维与合规红线意识，筑牢公司治理根基。

（四）分红回报方面。公司已发布《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》，明确了利润分配原则、方式及现金分红比例。公司拟实施 2026 年半年度利润分配方案，以实施 2026 年半年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.16 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。截至 2026 年 6 月 30 日公司总股本为 468,254,966 股，以此计算拟派发现金红利总额为 54,317,576.06 元（含税），占公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 36.87%。公司 2026 年半年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，该项议案尚需提交股东会审议，审议通过之后方可实施。

四、其他相关说明

公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案各项措施均在顺利实施中，公司将持续关注投资者意见建议，推进“提质增效重回报”行动方案的相关工作，聚焦主业发展、提升经营质量和效率、加快发展新质生产力、坚持规范运作、加强投资者沟通、强化“关键少数”责任。公司将持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，共同促进资本市场稳定健康发展。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等属于非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

四川华丰科技股份有限公司

2026 年 8 月 29 日